

# ステンレスベース 回路基板材料

ステンレス基材のため寸法変化の要求が厳しい用途や  
 基材の剛性が必要な用途に最適な回路基板材料



## 【特長】

- ・ ステンレス基材のため、剛性が高く寸法安定性に優れる
- ・ 低熱膨張係数、高接着性ポリイミドを使用
- ・ 熱可塑性ポリイミドは不使用→高い耐熱性
- ・ ポリイミドの薄膜化が可能 (min 5 $\mu$ m/std 10 $\mu$ m)

## 【構成】



構成	種別	厚み範囲	標準厚み
銅	電解銅めっき	5-9 $\mu$ m	9 $\mu$ m
ポリイミド	オリジナル PI	5-10 $\mu$ m	10 $\mu$ m
ステンレス	SUS304	18,20 $\mu$ m	20 $\mu$ m

## 【代表特性】

項目		単位	代表値	備考
ポリイミド特性	体積抵抗率	$\Omega \cdot m$	1.0E+14 以上	
	誘電率	-	3.3	1GHz
	誘電正接	-	0.017	1GHz
	熱膨張係数	ppm/K	19.5	100-200 $^{\circ}$ C
	湿度膨張係数	ppm/%RH	10.7	
	ガラス転移温度	$^{\circ}$ C	320	
	5%重量減少温度	$^{\circ}$ C	470	
接着力	銅-ポリイミド	kN/m	0.7	
	SUS-ポリイミド	kN/m	1.8	

※上記データは参考値です。

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>  
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122  
 東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 1-18-9 黒門平成ビル5階 TEL (03) 5846-8228  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル4階D室 TEL (06) 6476-7725